



TECHWISE FOGANG(TSF)



科惠白井(佛冈)电子有限公司

中国广东省清远佛冈市石角镇建滔工业园

电话: **(86-763)4296800** 传真: **(86-763)4287599**

产品类型

- » 双面和高多层印制线路板

主要产品特征

- » 月产量1200000平方尺
- » 最大板件尺寸: 24"×35"
- » 最大板厚: 200 mil
- » 最大纵横比: 10:1
- » 层数: 4层为主
- » 线粗/线隙: 3/3mil (外层) & 3/3 mil(内层)
- » 最小芯板厚度: 2.5 mil(不含铜)
- » 盲埋孔
- » 沉孔
- » 阻抗及差分阻抗
- » 多种表面处理
- » 板边电镀



TECHWISE FOGANG(TSF)

公司认证

- ▶ ISO9001
- ▶ ISO14001
- ▶ UL 796
- ▶ ROHS
- ▶ ISO/TS16949

物理特性

- ▶ 内层铜厚0.25-6oz
- ▶ 外层铜厚0.25-6oz
- ▶ SMT Pitch12 mil
- ▶ 芯板厚度.....2.5- 96 mil
(不含铜)
- ▶ 板厚5-280 mil
- ▶ 孔径纵横比10:1

CAD/CAM

- ▶ 奥宝工作站
- ▶ 奥宝光绘机

产能

- ▶ 内层产能: 200000平方尺/月
- ▶ 外层产能: 1200000平方尺/月

制程能力

- ▶ 线粗/线隙
 - 内层.....3/3mil
 - 外层.....3/3mil
- ▶ 阻抗控制.....8%
- ▶ 最小孔径/盲孔孔径.....8mil
- ▶ 绿油桥.....光亮油墨2 mil
.....哑色油墨 3 mil
- ▶ 板厚公差.....8%
- ▶ 板曲 0.7% (min)
- ▶ 内层焊环.....DHS+10mil
- ▶ 外层焊环.....DHS+10mil
- ▶ 孔到边公差.....±5mil
- ▶ 图形到边公差..... ±5mil

板材

- ▶ FR4 (Tg 140°C, 150°C and 170°C), 无铅
无卤板材
- ▶ CEM-3
- ▶ 低介质损耗板材 - Rogers Getek, Teflon,
BT, FR 408 and IS620
- ▶ 铝基/金属基



TECHWISE FOGANG(TSF)

表面处理

- » 喷锡
- » 抗氧化
- » 沉锡
- » 沉金
- » 镀厚金/金手指
- » 碳油
- » 沉银
- » 蓝胶

防焊(绿油)

- » 太阳, Tamura, 亨斯迈, 尚洪, 高仕

测试设备

- » AOI
 - 奥宝/网屏 AOI
- » 电测
 - 明信 E-T测试机, 凯码 E-T测试机
 - ATG E-T测试机,
- » - ATG and MicroCraft Emma 飞针测试机
- » 实验室检测
 - 微切片检测 - 成品检测
 - 互连热应力和 热冲击测试
 - 离子迁移测试



TECHWISE FOGANG(TSF)

主要设备

- ▶ 开料：ACS 自动切割机
- ▶ 内层：BURKLE 辘板机
UVE-M720 曝光机
- ▶ 内层酸蚀：扬博 DES 线
- ▶ 棕化：宇宙棕化线
- ▶ 压合：Mass Lamination Hequar
- ▶ 钻孔：Mark/SO2/ Excellon / Pluritec 钻机
- ▶ 外层干菲林：志圣/ HAKUTO 辘板机
志圣曝光机
- ▶ 外层碱蚀：宇宙 SES 线
- ▶ 防焊(绿油)：半自动丝印机
志圣 & ORC 曝光机
- ▶ 喷锡：垂直喷锡机
- ▶ 成型：TL/MAXIMA 锣机
SHODA /NCV-600/SCHMOLL V-CUT 机